

# しんきん日米半導体株ファンド

追加型投信／内外／株式

テクノロジーの進化を支える半導体株にシンプル投資！

販売用資料

[ 2025年2月作成 ]

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは

**Rakuten 楽天証券**


商号等/楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■設定・運用は

 しんきんアセットマネジメント投信株式会社

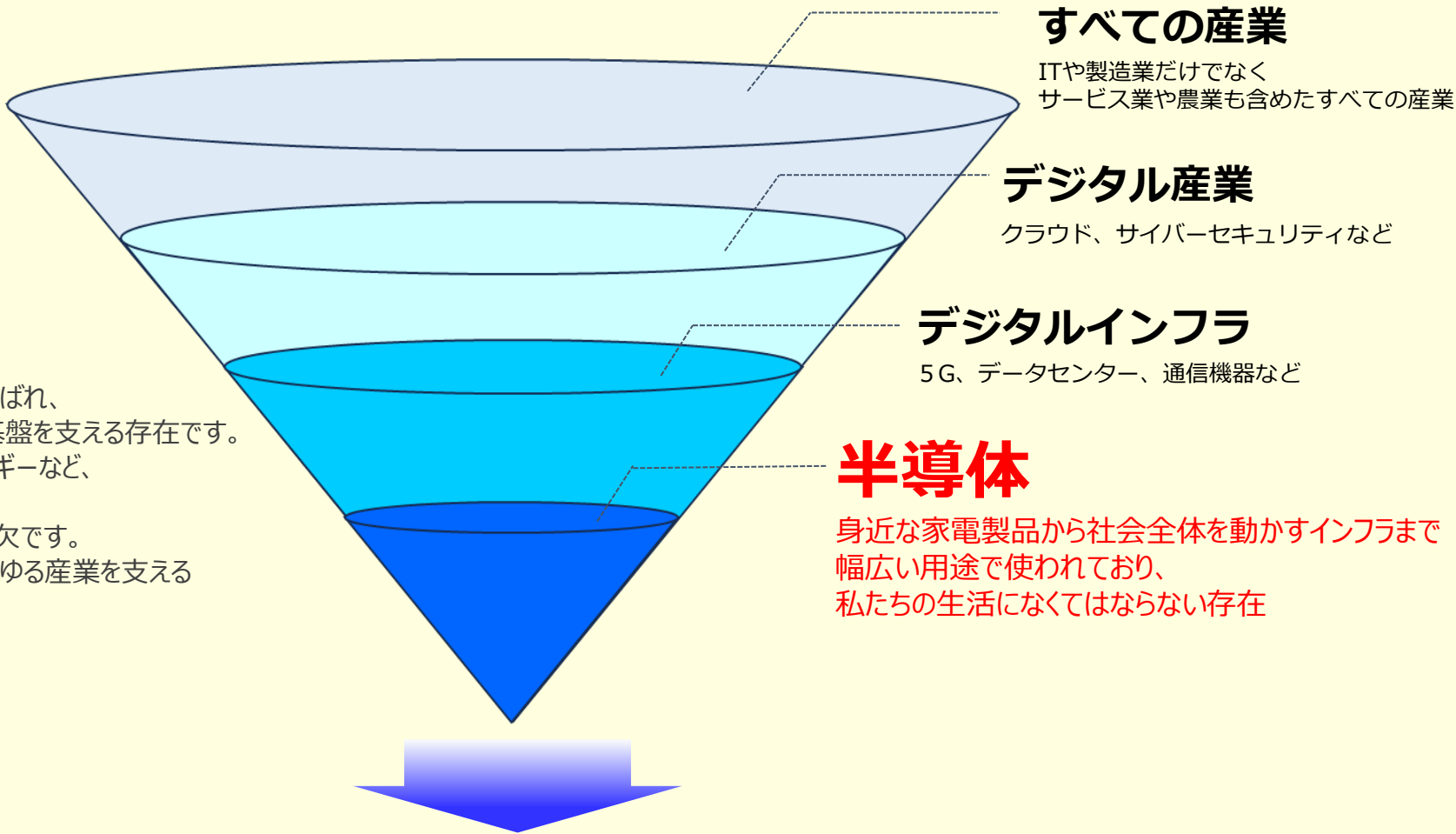
商号等/しんきんアセットマネジメント投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号

加入協会/一般社団法人投資信託協会、

一般社団法人日本投資顧問業協会

# 全ての産業の根幹となる半導体



## すべての産業

ITや製造業だけでなく  
サービス業や農業も含めたすべての産業

## デジタル産業

クラウド、サイバーセキュリティなど

## デジタルインフラ

5G、データセンター、通信機器など

## 半導体

身近な家電製品から社会全体を動かすインフラまで  
幅広い用途で使われており、  
私たちの生活になくてはならない存在

半導体は「産業のコメ」と呼ばれ、あらゆる製品やサービスの基盤を支える存在です。AI、自動車、医療、エネルギーなど、多分野の成長を促進し、経済や社会の発展に不可欠です。半導体は、今や現代のあらゆる産業を支える「基盤」といえます。

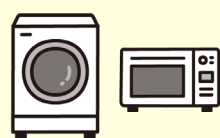
### 情報端末



### PC・OA機器



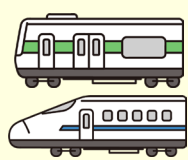
### 家電製品



### 自動車



### インフラ



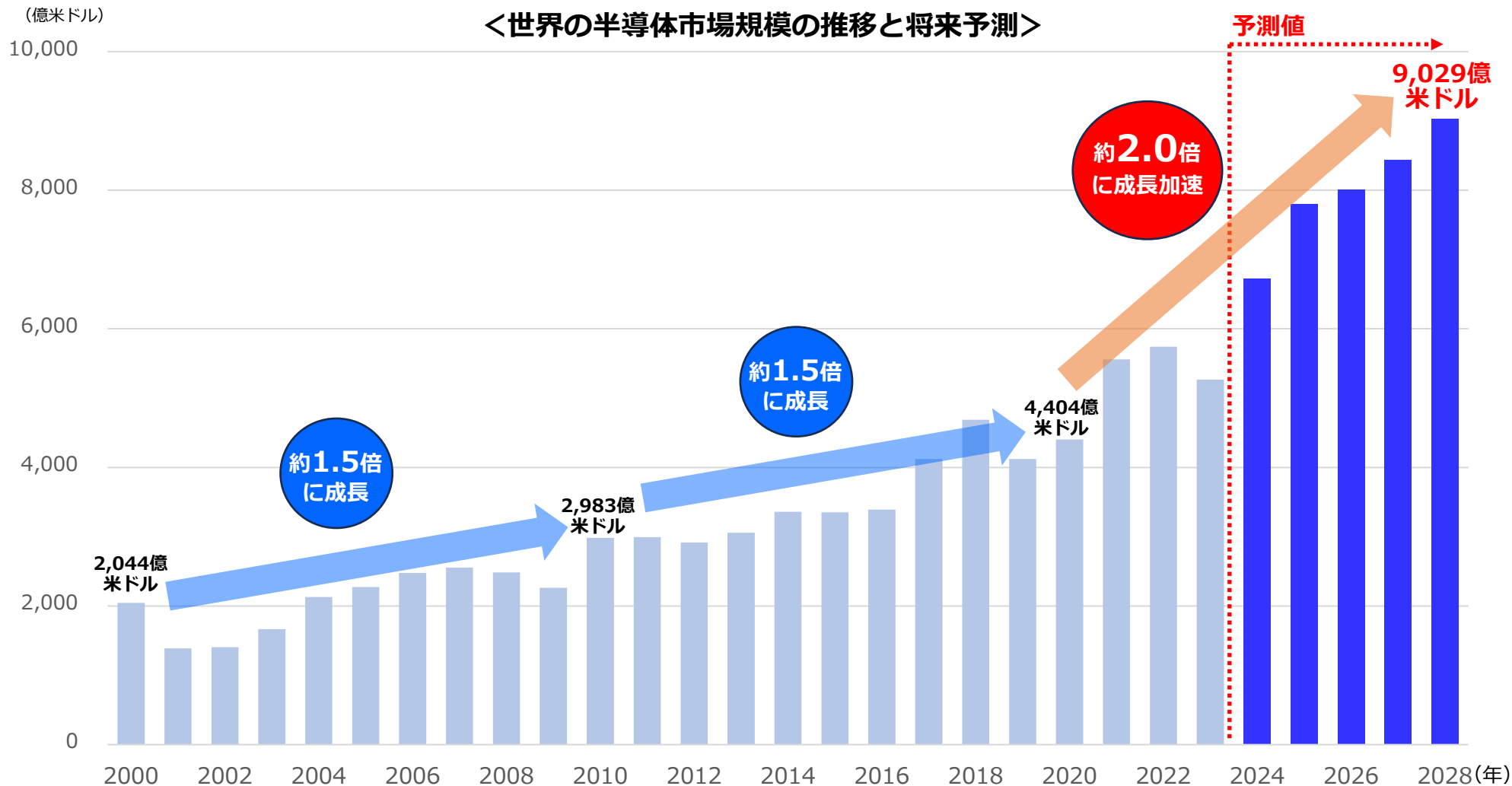
### 人工知能



※上記は、イメージ図でありすべてを網羅したものではありません。  
(出所) 経済産業省資料他より、しんきん投信作成

# 成長が加速する半導体市場

これまでの技術革新の歴史を背景に成長を遂げてきた半導体のマーケットですが、今後もデータ量の爆発的な増加が見込まれており、パソコンやスマートフォンといった身近なハイテク製品だけではなく、データセンターやロボティクスなどあらゆる分野で、さらなる活用が見込まれています。また、生成AI（人工知能）の進展や、EV（電気自動車）による自動運転技術の進展も相まって、半導体の需要はより一層高まることが想定されます。



（出所）2000年～2023年：WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS（世界半導体市場統計）よりデータ取得し、しんきん投信作成  
2024年～2028年（予測）：Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

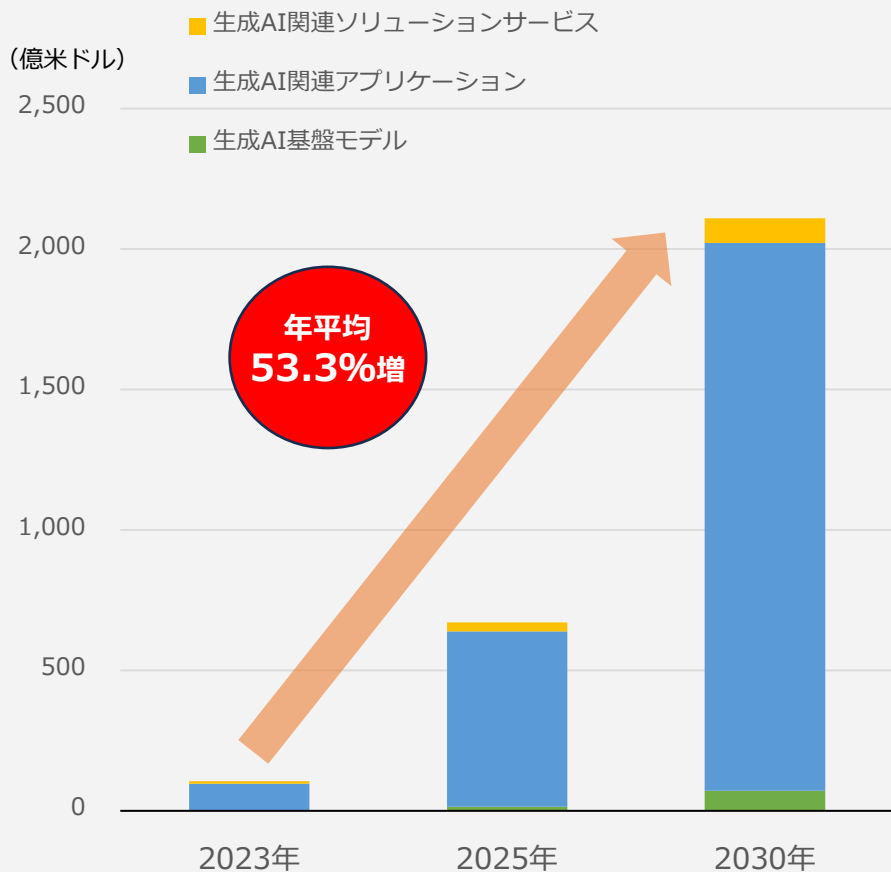
※上記は、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

※巻末の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。

# 半導体市場の成長を牽引する生成AI

生成AIは、膨大なデータ処理や高度な演算を可能にする半導体技術なしでは成り立ちません。その普及に伴い、高性能の半導体への需要が爆発的に増加しています。生成AIは、エンターテインメントから医療、製造業まで幅広い分野で活用されており、それに対応する先端半導体の開発が市場成長を加速させています。

## ＜生成AI市場の見通し＞



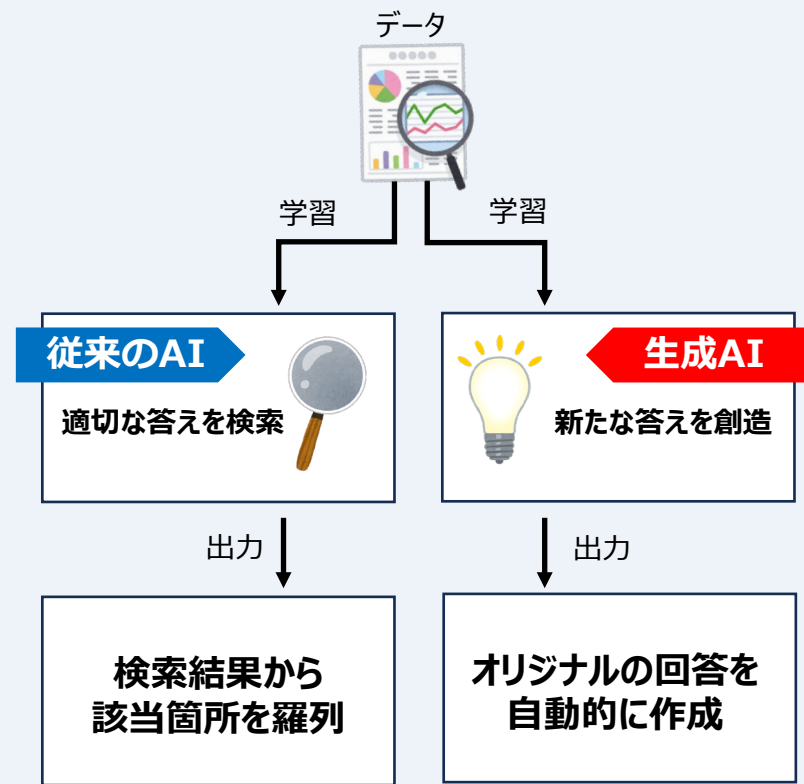
(出所) 2023年一般社団法人電子情報技術産業協会の見通しを基に、しんきん投信作成  
※すべて予測値

※上記は、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。  
また、当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

## 生成AIとは

生成AIとは、データを基に新しいコンテンツや情報を自動的に生成する人工知能です。画像、音楽、文章、設計など多様な分野で活用されています。

### 「従来のAI」と「生成AI」の違い



※上記は従来のAIと生成AIの一般的な違いを示したイメージ図です。

# 国策が半導体産業への多額の投資を促進

各国・地域が、経済安全保障の観点から半導体の重要な生産基盤を囲い込むため、異次元の支援策等を実施しています。

## 主要国・地域の半導体産業への政策支援

日本



- 「AI・半導体産業基盤強化フレーム」に基づき、2030年度までにAI・半導体分野に10兆円以上の公的支援をする方針

米国



- 「The CHIPS and Science Act of 2022」（チップス法）が成立
- 5年で500億ドル（約7.8兆円）を投資する方針

欧州



- 2022年「欧州半導体法案」を発表
- 2030年までに累計430億ユーロ（約6.9兆円）規模の官民投資を計画

台湾



- 2023年「産業創新条例（台湾版CHIPS法）」の改正案が可決
- 半導体関連の研究開発費用に最大で25%の税額控除を適用

韓国



- 2022年「半導体超強大国達成戦略」を発表
- 2026年までに、340兆ウォン以上（約35.7兆円以上）を投資する方針

※次の為替レートで計算：1米ドル=155円、1ユーロ=160円、100ウォン=10.5円

(出所) ●日本：  
令和6年11月閣議決定「『国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策』について」を基にしんきん投信作成  
●その他：  
令和5年6月 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」から抜粋

※当ファンドにおける保有及び将来の組入れを示唆するものではありません。  
また、特定銘柄の売買などの推奨、及び価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

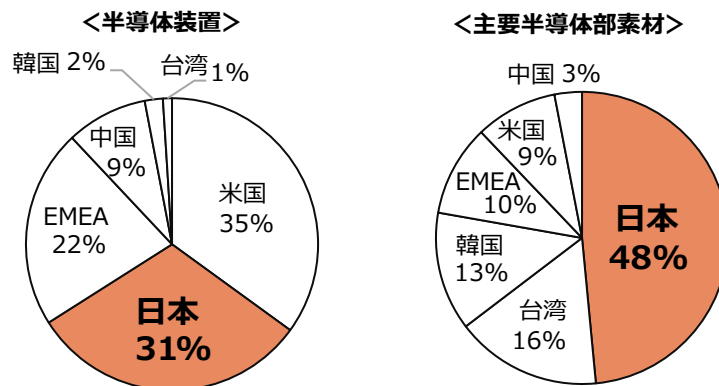
※巻末の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。

## 国内外からの投資について



日本国内では、トヨタやソニーといった日本国内大手企業8社が共同出資して設立されたラピダスが国内で大規模な投資を行っています。またTSMC（台湾）やマイクロンテクノロジー（米国）などのグローバル企業も日本で大型投資を行っています。日本への投資を決めた理由に、日本に半導体の製造装置と部素材の強固な産業基盤があることがよく挙げられます。今後も国内半導体関連企業への期待は大きいものと考えられます。

## 半導体装置・部素材の各国シェア状況



※EMEAとは：英語の"Europe, the Middle East and Africa"の略で、ヨーロッパ、中東及びアフリカを指す。  
※令和5年6月 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」から抜粋（2021年実績）

# 半導体の製造工程

半導体の設計と製造は分業体制で進めることが主流となっています。

## 設計

IC（集積回路）に必要な性能や機能の配置を決める  
回路／レイアウト設計

委託

## 製造

### 前工程

シリコンウエハに多数のICチップを同時に作りこむ

### 後工程

完成したシリコンウエハをICチップに切り分け、組み立てを行う

納入

## 製造装置、部素材

## <ご参考> 各製造工程における代表的な企業

### 設計（ファブレス企業）

※ファブレス企業とは…  
製造工場を持たない企業のことです。

エヌビディア（米）、ブロードコム（米）  
クアルコム（米）、アーム・ホールディングス（英）

### 設計&製造

インテル（米）、テキサス・インスツルメンツ（米）

### 製造（ファウンドリー企業）

TSMC（台）

※ファウンドリー企業とは…  
製造に特化した企業のことです。

### 製造装置、部素材

アプライドマテリアルズ（米）、ASML（蘭）、KLA（米）  
東京エレクトロン（日）、アドバンテスト（日）  
SUMCO（日）、信越化学工業（日）



- 日本企業は主に製造装置や部素材の分野で強みを持っています。
- アメリカ企業は特に半導体設計と製造で強みを発揮しており、半導体産業の技術革新をリードしています。

※各製造工程における代表的な企業については、2024年12月末現在のものです。  
当ファンドにおける保有及び将来の組入れを示唆するものではありません。  
また、特定銘柄の売買などの推奨、及び価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

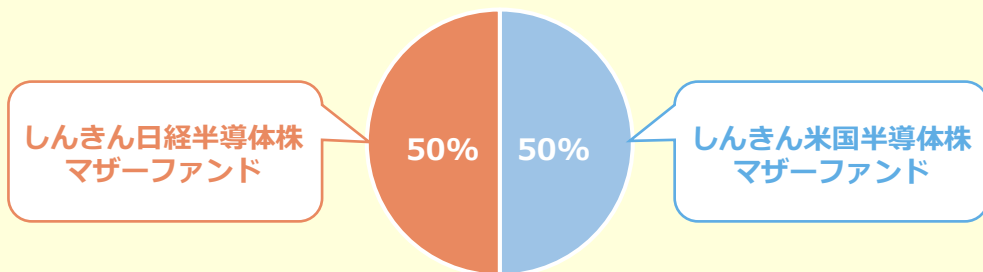
# ファンドの特色

## ◆ マザーファンドを通じて日本と米国の金融商品取引所に上場している半導体関連株式に投資を行います。

- 「しんきん日経半導体株マザーファンド」および「しんきん米国半導体株マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象とします。
- 各マザーファンドの組入比率は、以下を基本とします。なお、月次でリバランスを実施します。

<ポートフォリオのイメージ>

基本組入比率



- 効率的な運用を行うため、日本と米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券（上場投資信託証券、以下「ETF」といいます。）を実質的に組み入れることがあります。

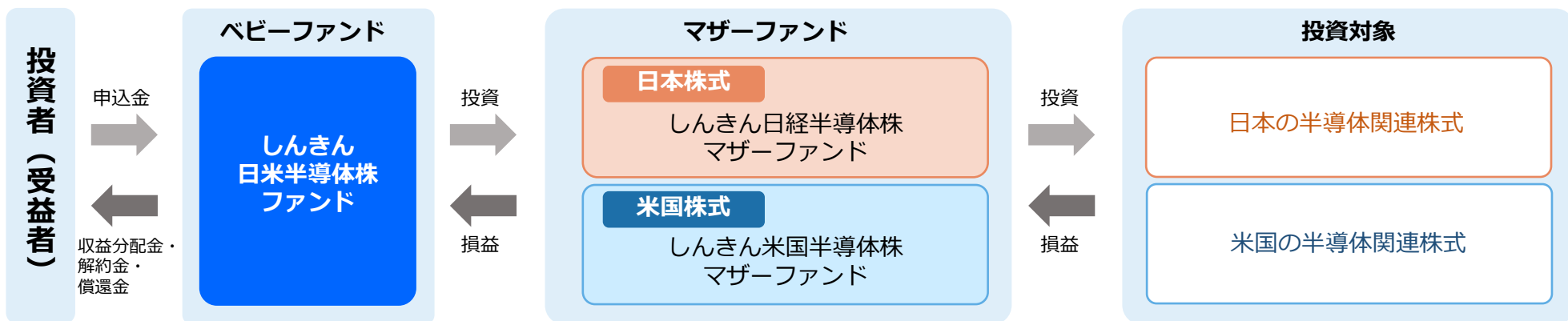
<マザーファンドの概要>

日本	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 日経半導体株指数（トータルリターン）に連動する投資成果を目標として運用を行います。</li> <li>■ 上記の指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、ETFを組み入れる場合があります。</li> <li>■ 株式およびETFを合計した組入比率は、原則として高位を保ちます。</li> </ul>
米国	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NYSE Semiconductor Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。</li> <li>■ 次の運用方法のいずれかまたは両方を組み合わせた運用を行います。運用方法の選択および組合せは、運用の効率性等を勘案のうえ決定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● NYSE Semiconductor Indexへの連動を目指すETFに投資を行う方法</li> <li>● 米国の金融商品取引所上場の株式（ADR（米国預託証券）を含みます。）に投資を行う方法</li> </ul> </li> <li>■ ETFおよび株式を合計した組入比率は、原則として高位を保ちます。</li> </ul>

## ◆ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## ファンドの仕組み



※各マザーファンドがETFを組み入れた場合には、別途運用管理費用が掛かります。※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

# 当ファンドに関連する半導体株指数（日本）

## 日経半導体株指数

株式会社日本経済新聞社が公表する指数で、東京証券取引所に上場する主要な半導体関連銘柄から構成されます。  
時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。

### <日経半導体株指数(トータルリターン)の推移>



出所：(株)日本経済新聞社の資料等、Bloombergのデータを基に、しんきん投信作成  
※遡及算出開始日である2011年11月30日を1,000としています。  
※日経半導体株指数（トータルリターン）の推移はあくまで参考情報であり、当ファンドの運用実績ではありません。  
※過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。



# 上位10銘柄（日経半導体株指数）

※2024年12月末時点

銘柄	
1	東京エレクトロン 半導体製造に必要な多種多様な装置を製造する。
2	アドバンテスト 半導体デバイスが正常に動くかをテストする検査装置を手掛けるメーカー
3	ディスコ シリコンウエハーを削る、磨く、切断する、といった工程で、独自技術を持つ装置メーカー
4	ルネサスエレクトロニクス マイコン世界大手。マイコンとセンサーなどをセット販売する戦略で収益を伸ばす。 (※マイコンとは：マイクロコントローラの略。その電気機器を制御するための電子部品。最近のほとんどの電子機器に組み込まれている。)
5	ソニーグループ スマートフォン、デジタルカメラなどに使用されるイメージセンサーを手掛ける。
6	HOYA 半導体製造用材料メーカー
7	信越化学工業 半導体シリコンおよび石英などの電子材料の製造および販売を行う。
8	レーザーテック 半導体検査・計測装置の製造を主力で行う。
9	SCREENホールディングス 半導体製造装置の製造・販売を行う。
10	日産化学 半導体材料メーカー

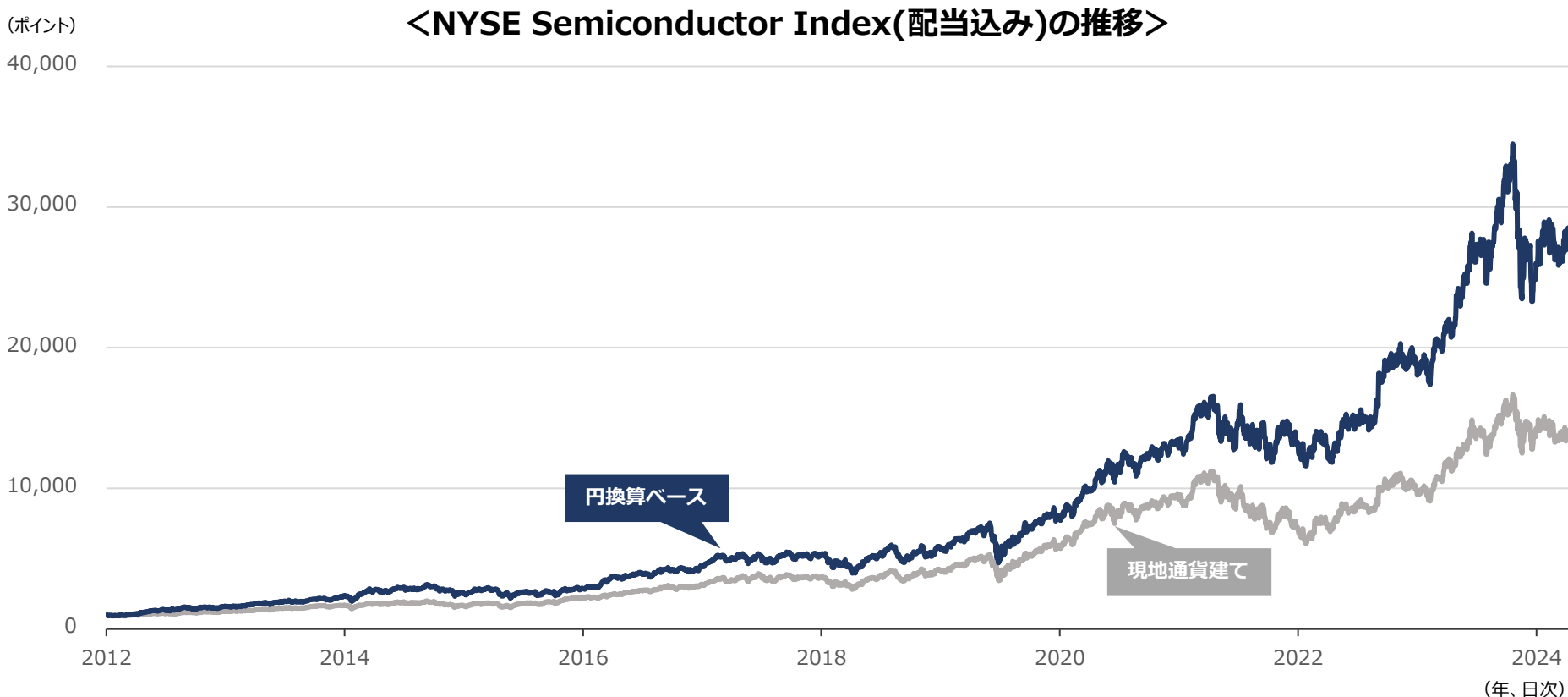
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

※指数の上位構成銘柄を説明することを目的とするもので、当ファンドにおける保有及び将来の組入れを示唆するものではありません。  
また、特定銘柄の売買などの推奨、及び価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

# 当ファンドに関連する半導体株指数（米国）

## NYSE Semiconductor Index

ICE Data Indices, LLC が算出する指数で、米国の金融商品取引所に上場する半導体関連銘柄から構成されます。  
時価総額上位30銘柄で構成されています。



(期間：2012年9月21日～2024年12月末)

出所：ICE Data ServicesおよびBloombergのデータを基に、しんきん投信作成

※遡及算出開始日である2012年9月21日を1,000として指数化しています。

※円換算ベースはしんきん投信で計算

※NYSE Semiconductor Index(配当込み)の現地通貨建ておよび円換算ベースはあくまで参考情報であり、当ファンドの運用実績ではありません。

※過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

# 上位10銘柄 (NYSE Semiconductor Index)

※2024年12月末時点

銘柄	国・地域
1 ブロードコム 半導体デバイスの開発、設計、販売を手がける。	米国
2 エヌビディア 画像処理用のGPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）を開発し、主にゲーム向けやデータセンター向けとして製造・販売	米国
3 アドバンスド・マイクロ・デバイセズ カリフォルニア州を拠点とし、半導体の設計・開発を手掛ける。	米国
4 クアルコム CDMA技術の開発ノウハウで、同技術をベースにした集積回路や無線チップ、ソフトウェアを生産する。	米国
5 テキサス・インスツルメンツ 世界30カ国超の市場で、半導体の設計・製造・販売を手掛ける。	米国
6 マーベル・テクノロジー データセンターの中核部分～ネットワークのエッジ（端）まで、幅広いデータインフラ向け半導体ソリューションを設計・開発・販売するファブレス半導体メーカー	米国
7 アナログ・デバイセズ 高性能アナログ集積回路（IC）などの設計・製造・販売を手掛けるグローバル企業	米国
8 KLA シリコンバレーに拠点を置く、半導体検査・測定装置の開発・製造企業	米国
9 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セミコンダクター] 垂直統合型が主流だった半導体業界にあって、初めて専業ファウンドリー（工場）ビジネスを確立	台湾
10 アプライド・マテリアルズ 半導体製造装置メーカー	米国

（出所）Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

※指数の上位構成銘柄を説明することを目的とするもので、当ファンドにおける保有及び将来の組入れを示唆するものではありません。また、特定銘柄の売買などの推奨、及び価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

# 上位銘柄紹介（日経半導体株指数）

## 東京エレクトロン

半導体製造装置を製造する国内最大手メーカー。半導体がより小さく、また多様化、複雑化する中で、技術革新の要となるのは繰り返し行われる工程であり、同社はその工程すべてに製造装置を開発している。

※2024年12月末時点

### <株価とEPSの推移>



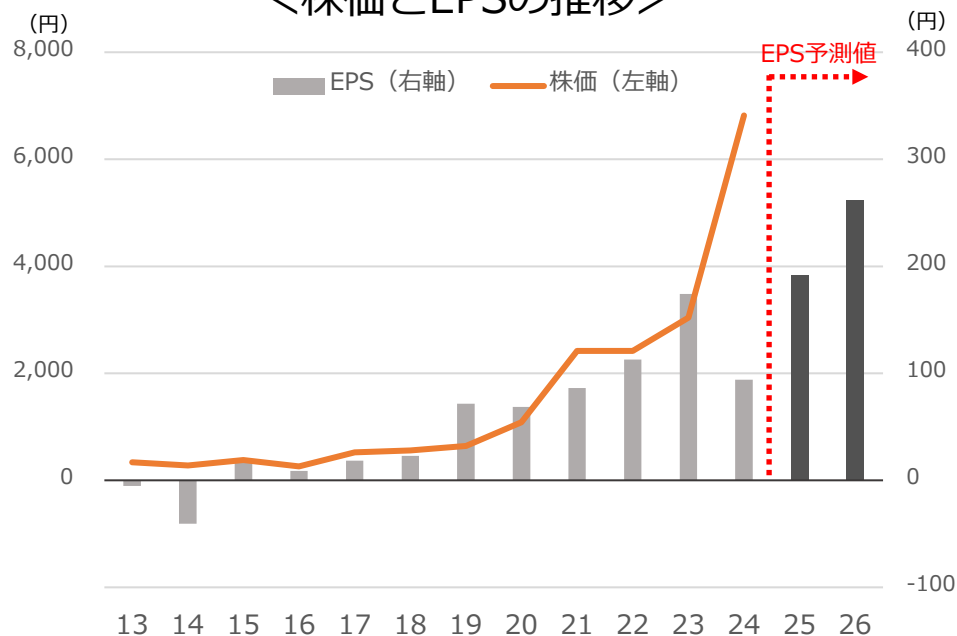
(出所) Bloombergのデータを使用して、しんきん投信作成  
 ※各決算月末の株価と一株あたり利益を表示  
 ※株価は2013年3月末～2024年3月末まで（年次）  
 ※EPSは2024年までは実績、2025年以降は予測値（2024年12月末現在）  
 ※株価とEPSの推移は株式分割等の権利調整後の値

## アドバンテスト

半導体チップやシリコンウエハの電気特性を測るテスト装置の製造で世界的に高いシェアを誇る。

※2024年12月末時点

### <株価とEPSの推移>



(出所) Bloombergのデータを使用して、しんきん投信作成  
 ※各決算月末の株価と一株あたり利益を表示  
 ※株価は2013年3月末～2024年3月末まで（年次）  
 ※EPSは2024年までは実績、2025年以降は予測値（2024年12月末現在）  
 ※株価とEPSの推移は株式分割等の権利調整後の値

※「EPS」とは・・・Earning Per Shareの頭文字をとった略語で、日本語で言えば1株あたりの純利益です。発行している1株に対して企業がどれだけ利益を生み出しているのかを示す指標となります。

※指数の上位構成銘柄を説明することを目的とするもので、当ファンドにおける保有及び将来の組入れを示唆するものではありません。また、特定銘柄の売買などの推奨、及び価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。  
 ※過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

※巻末の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。

# 上位銘柄紹介 (NYSE Semiconductor Index)

## ブロードコム

ストレージ・アダプター、コントローラー、ネットワーキング・プロセッサ、モーションコントロール・エンコーダ製品、光センサーのほか、複雑なハイブリッド環境を最新化、最適化、および安全を確保するためのインフラやセキュリティソフトウェアを提供する企業

※2024年12月末時点

### <株価とEPSの推移>



(出所) Bloombergのデータを使用して、しんきん投信作成

※各決算月末の株価と一株あたり利益を表示

※株価は2013年10月末～2024年10月末まで (年次)

※EPSは2024年までは実績、2025年以降は予測値 (2024年12月末現在)

※株価とEPSの推移は株式分割等の権利調整後の値

## エヌビディア

半導体を製造する施設は持たず、開発・設計に特化。3Dインターネット技術によるメタバース空間や未来のAI工場、自動運転車、ゲーム等、幅広い領域に向けた最先端の半導体チップ、システム、ソフトウェアの開発を手掛ける企業

※2024年12月末時点

### <株価とEPSの推移>



(出所) Bloombergのデータを使用して、しんきん投信作成

※各決算月末の株価と一株あたり利益を表示

※株価は2013年1月末～2024年1月末まで (年次)

※EPSは2024年までは実績、2025年以降は予測値 (2024年12月末現在)

※株価とEPSの推移は株式分割等の権利調整後の値

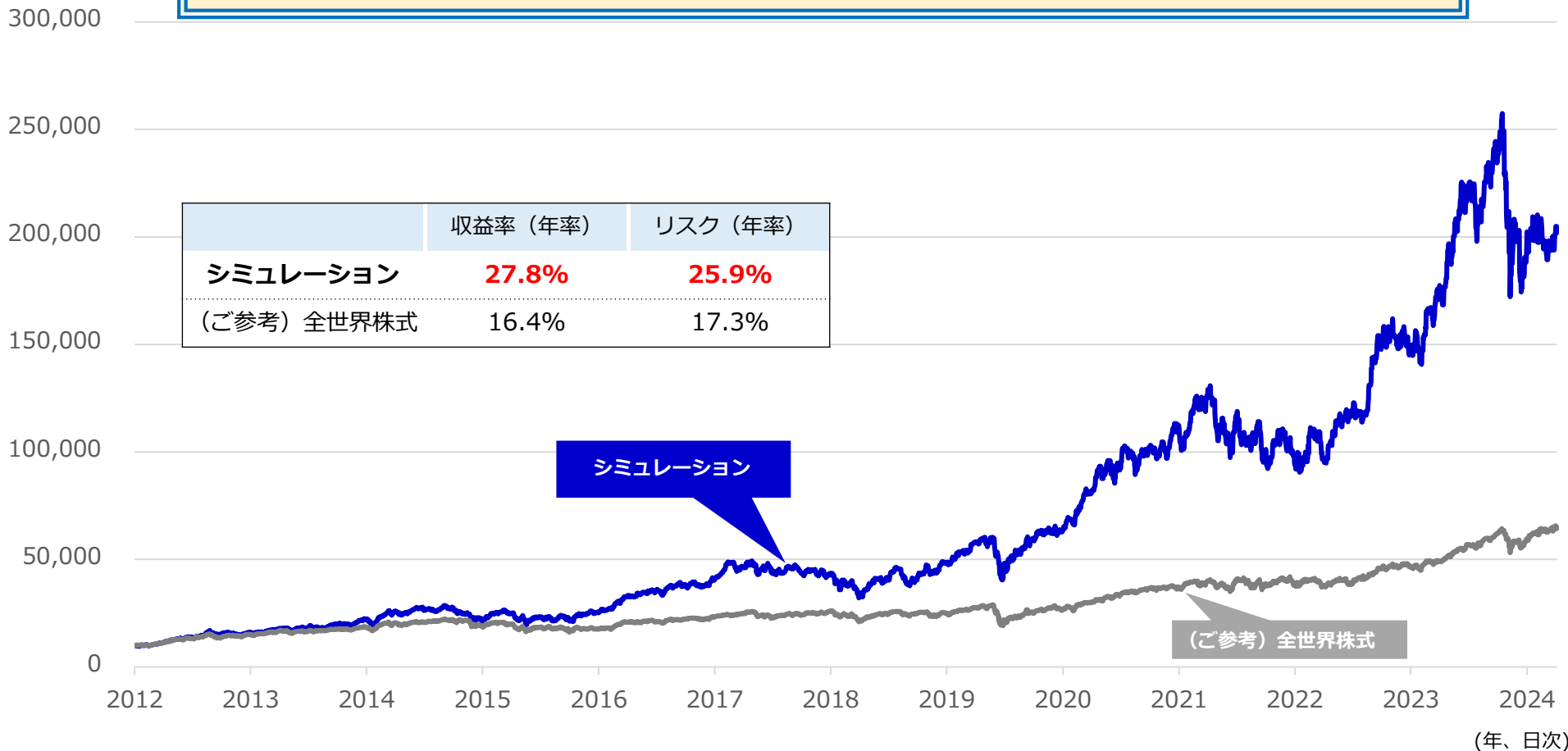
※指数の上位構成銘柄を説明することを目的とするもので、当ファンドにおける保有及び将来の組入れを示唆するものではありません。また、特定銘柄の売買などの推奨、及び価格の上昇や下落を示唆するものではありません。  
※過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

※巻末の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。

# (ご参考)当ファンドのシミュレーション

## 【シミュレーションの前提条件】

- ・ 2012年9月末に日経半導体株指数（配当込み）およびNYSE Semiconductor Index（配当込み、円換算ベース）に等金額になるように一括で投資
  - ・ 月末にリバランスを実施
  - ・ 終値を使用
  - ・ 投資期間2012年9月末～2024年12月末
- ※上記は過去のデータをもとに行ったシミュレーションであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。  
また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。  
※信託報酬および税金等の諸費用は考慮していません。



【出所】 Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

※「全世界株式」：MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み・円換算ベース）

(期間：2012年9月末～2024年12月末)  
(2012年9月末を10,000として指数化)

# しんきん米国半導体株マザーファンドを通じて、実質的に投資する投資対象ファンドの概要

ETF（上場投資信託）銘柄	iShares Semiconductor ETF
連動を目指す指標	NYSE Semiconductor Index
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している株式で構成されるNYSE Semiconductor Index に連動する投資成果を目指します。
運用会社（管理会社）	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
取引通貨	米ドル
運用管理費用（年率）	0.35% 程度

※上記内容は今後変更となる場合があります。

※投資するETFは、委託会社の判断により変更する可能性があります。

## ◆ブラックロック・ファンド・アドバイザーズについて◆

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」といいます。）の一員です。ブラックロックは、世界約30か国に拠点を擁し、約1,815兆円（2024年12月末現在）を運用する世界有数の資産運用グループです。

◆ETFとは◆ ETFはExchange Traded Fundの略で、上場投資信託と呼ばれます。

主な特徴は以下の通りです。

**特徴 1** 株式と同様に取引所に上場され、取引時間中はリアルタイムで取引ができます。  
通常の投資信託は1日1つの基準価額ですが、ETFは市場で取引され、価格は常に変動しています。

**特徴 2** 多くのETFは株価指数に連動することを目指して運用されます。  
日本国内においてもTOPIXなど、様々な指標に連動するETFが設定されています。

**特徴 3** リスク分散効果が見込めます。  
株価指数に連動することを目指すETFは、株価指数を構成する数多くの株式を投資対象としているため、個別銘柄に投資するよりも、リスク分散が図れます。

# 収益分配・外国為替市場の影響について

## 収益分配について

年1回の決算時（12月20日（休業日の場合は翌営業日））に収益分配方針に従って分配を行います。  
下記の図はイメージであり、将来の分配金をお約束するものではありません。分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

### 収益分配金のお支払いのイメージ



※自動けいぞく投資を選択されている場合、分配金は自動的に再投資されます。（再投資の際に、購入時手数料は掛かりません。）  
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 収益分配方針

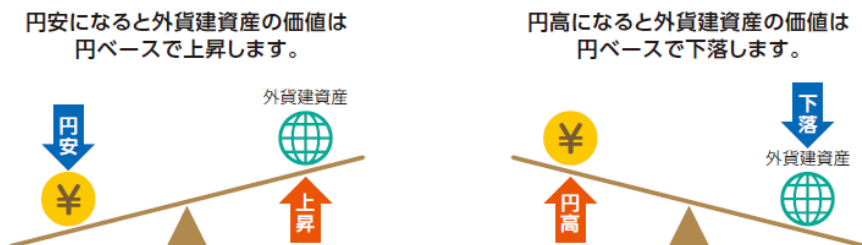
- 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

## 外国為替市場の影響について

当ファンドは、資産のほぼ半分を外貨建資産に投資します。

- 外国為替相場の変動の影響を受けますので、投資先の通貨に対して円安になると為替差益が期待できますが、一方で、投資先の通貨に対して円高になると為替損失を被る可能性があります。また、当ファンドでは原則として外国為替相場の影響を回避する取引（いわゆる為替ヘッジ）は行いません。

### 為替変動と外貨建資産価値のイメージ



※上記は一般的な場合の説明であり、様々な条件により異なる場合があります。

※巻末の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。



# ファンドの投資リスク

「しんきん日米半導体株ファンド」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。  
したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

**【基準価額の変動要因】** ※下記の変動要因は主なもののみであり、下記に限定されるものではありません。



## 価格変動 リスク

有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。当ファンドは、一銘柄当たりの実質的な組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。また、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。



## 為替変動 リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。



## 信用リスク

有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。



## 流動性 リスク

流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。



## カントリー リスク

海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。

- 【その他の留意点】**
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。
  - 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

# お申込みメモ、ファンドの費用

## お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位
購入価額	<当初申込期間> 1口当たり1円 <継続申込期間> 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額（信託財産留保額はありませぬ。）
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
申込受付中止日	ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日
購入の申込期間	<当初申込期間> 2025年3月13日から2025年3月27日まで <継続申込期間> 2025年3月28日から2026年3月13日まで (継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
信託期間	無期限（当初設定日：2025年3月28日）
繰上償還	委託会社は、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。
決算日	毎年12月20日（休業日の場合、翌営業日）です。 初回決算日は2025年12月22日です
収益分配	年1回の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。 収益分配金の再投資またはお受け取りについては、販売会社にお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 配当控除の適用はありません。益金不算入制度の適用はありません。 ※税法の改正によって変更される場合があります。

## ファンドの費用

### ① 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入金額に応じて、購入価額に <b>2.2%（税抜2.0%）を上限</b> に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額を購入時にご負担いただきます。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額	ありませぬ。

### ② 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）	純資産総額に対して、 <b>年率0.55%（税抜0.50%）</b>	
	投資対象とする投資信託証券	年率0.35%程度 (投資対象とする投資信託の運用管理費用) ※投資対象とする投資信託の運用管理費用は年度によって異なるため、変動することがあります。なお、各マザーファンドにおける実際の投資信託の組入状況によっても変動します。
	実質的な負担	<b>年率0.725%（税込）程度</b> (当ファンドの基本組入比率（50%：50%）に基づいて、米国株式への投資を投資信託証券により行った場合の運用管理費用も加味した実質的な信託報酬の目安です。)
その他費用・手数料	監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等および外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。	

※上記の実質的な負担は、日米両国の投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること等から、変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な負担については概算で表示しています。  
※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

# 税金

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および 地方税	・配当所得として課税* ・普通分配金に対して20.315%
換金（解約）時 および償還時	所得税および 地方税	・譲渡所得として課税* ・換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

\* 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。

※ 上記は、2024年11月末現在の情報をもとに記載しています。なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 法人の場合は上記と異なります。

※ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



# しんきんアセットマネジメント投信

## 日経半導体株指数

・「日経半導体株指数」は、株式会社日本経済新聞社（以下「日経」という。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経半導体株指数自体及び日経半導体株指数を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経半導体株指数を対象とする「しんきん日米半導体株ファンド」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経半導体株指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日経は、日経半導体株指数の構成銘柄、計算方法、その他日経半導体株指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

・日経半導体株指数は、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経半導体株指数をスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経半導体株指数の算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

## NYSE Semiconductor Index

日本語訳は参考としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものであり、英語版と日本語訳に矛盾・齟齬等がある場合は、英語版が優先されます。

出所：ICE Data Indices,LLC、「NYSE Semiconductor Index」は許可を得て使用されます。ICE<sup>SM</sup>は、ICE Dataまたはその関連会社のサービス/商標です。これらの商標は「しんきん日米半導体株ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）に関連して、当インデックスとともに、しんきんアセットマネジメント投信株式会社（以下、「しんきん投信」といいます。）による使用を許可されています。「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」および当ファンドのいずれも、ICE Dataおよび関連会社や第三者サプライヤー（以下、「ICE Data及びそのサプライヤー」といいます。）からは後援、支持、販売、推進されるものではありません。ICE Dataおよびそのサプライヤーは、一般的に有価証券、特に当ファンドへの投資の妥当性、または当インデックスが一般的な株式市場のパフォーマンスを追跡する能力に関して、いかなる表明や保証も行いません。インデックスの過去の推移は将来の投資成果を保証するものではありません。ICE Data およびそのサプライヤーは、明示的または黙示的を問わず、市場性または特定の目的または使用への適合性に関する保証を含む、あらゆる保証および表明を放棄します。これには、インデックス、インデックス データ、およびそれらに含まれる、それらに関連またはそれらから派生するあらゆる情報（「インデックスデータ」）が含まれます。ICE Data およびそのサプライヤーは、インデックスまたはインデックスデータの妥当性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負いません。インデックスまたはインデックスデータは「現状のまま」提供され、使用は自己責任で行うものとします。

Source: ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"). NYSE Semiconductor Index ("Index") is used with permission. "ICE<sup>SM</sup>" is a service/trade mark of ICE Data or its affiliates. These trademarks have been licensed, along with the Index for use by Shinkin Asset Management in connection with Shinkin Japan U.S. Semiconductor Equity Fund (the "Product"). Neither Shinkin Asset Management nor the Product, as applicable, is sponsored, endorsed, sold, or promoted by ICE Data, its affiliates or its Third Party Suppliers ("ICE Data and its Suppliers"). ICE Data and its Suppliers make no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Product particularly, or the ability of the Index to track general market performance. Past performance of an index is not an indicator of or a guarantee of future results.

ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/ OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION INCLUDED IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM ("INDEX DATA"). ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES OR THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK.

## <本資料に関してご留意していただきたい事項>

- ※ 本資料は、ご投資家の皆様に「しんきん日米半導体株式ファンド」へのご理解を深めていただくことを目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ※ 本資料は、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- ※ 本資料の内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
- ※ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ※ 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
- ※ 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- ※ 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」を「しんきん投信」と略して表記する場合があります。